



特許証
(CERTIFICATE OF PATENT)

特許第6513885号
(PATENT NUMBER)

発明の名称
(TITLE OF THE INVENTION)

光集積回路、並びにこれを用いた光フェーズド
アレイ及びLiDARセンサ

特許権者
(PATENTEE)

東京都葛飾区奥戸3-16-19-204号
株式会社大成テクノロジー

発明者
(INVENTOR)

金成君

出願番号
(APPLICATION NUMBER)

特願2018-525790

出願日
(FILING DATE)

平成30年 5月14日(May 14, 2018)

登録日
(REGISTRATION DATE)

平成31年 4月19日(April 19, 2019)

この発明は、特許するものと確定し、特許原簿に登録されたことを証する。
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成31年 4月19日(April 19, 2019)

特許庁長官
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

宗像直子

